

平成 30 年度 助成

氏名:櫻井淳平



## 研究 経過・終了報告書

※ゴシック文字で記入下さい。

研究テーマ	超音波接合積層造形を用いたTi-Ni系高成形性形状記憶合金の三次元構造の作製
研究の結果	<p>①積層条件の基礎検討</p> <p>原理確認実験として、スパッタ法で作製したTi-Ni-Cu高成形性形状記憶合金薄膜(成膜直後では非晶質)を用いて、超音波接合を試みた。接合の様子を図1に示す。サンプルはその後引張試験を行うため、幅1mm長さ5mmの短冊形状を用いた。超音波振動機のホーンを垂直に押し当て加振し接合を試みた。印加荷重を2~6Nとし、加振時間を0.3~3.0sで行った。加振時間3.0sの条件で、印加荷重4N及び6Nで接合には成功した。しかし、4Nでは接合力が不十分であった。一方、6Nの方は図2に示すように接合には成功した。しかし、本来非晶質状態で接合を行ったかったが、接合部が結晶化していた。これは、接合時に表面の酸化膜を破壊して接合が起こる際、試料温度が結晶化温度を越えてしまったためと考えられる。4Nのサンプルでは、一部の結晶化にとどまっていたため、今後は事前に表面酸化膜の除去などの前処理を行う必要がある。また、今後積層を行うためには、サンプルが薄膜では実施が困難なため、単ロール法による急冷凝固によるリボンの作製を試みた。まだ条件の最適化を行っている段階ではあるが、ガラス転移を示すリボンサンプルの作製に成功した。今後は、本リボン材を用いて、酸化膜除去の前処理を行ったサンプルの接合実験を行いたい。</p> <p>行うためには、サンプルが薄膜では実施が困難なため、単ロール法による急冷凝固によるリボンの作製を試みた。まだ条件の最適化を行っている段階ではあるが、ガラス転移を示すリボンサンプルの作製に成功した。今後は、本リボン材を用いて、酸化膜除去の前処理を行ったサンプルの接合実験を行いたい。</p>
	<p>図1 超音波接合実験</p> <p>図2 超音波接合サンプル(6N-3.0s)</p>
研究発表 (実績)	<p>1 青山 榛祐, 岡 智絵美, 秦 誠一, 櫻井 淳平, Ti-Ni系高成形性形状記憶合金の接合方法の検討, 日本機械学会第26回機械材料・材料加工技術講演会(M&amp;P2018), (2018.11, 山形)</p> <p>2 青山 榛祐, 岡 智絵美, 秦 誠一, 櫻井 淳平, 高成形性形状記憶合金の接合法による接合強度評価, 第4回日本機械学会イノベーション講演会(iJSME2019),(2019.1.東京ビッグサイト)</p> <p>3 Ryosuke Aoyama, Hiroto Watanabe, Chiemi Oka, Seiichi Hata, Junpei Sakurai, Fabrication of Foldable Pipe Structures Using Ti-Ni Based High Formable Shape Memory Alloys, The 5<sup>th</sup> Asian Symposium on Materials and Processing (ASMP2018), 22 (2018.12, Bangkok, Thailand)</p>